

各種ハイブリッド I C

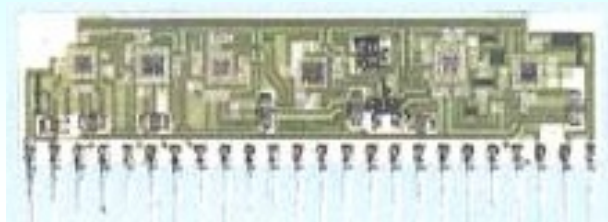
光山電気工業 ハイブリッド I C 製品

ハイブリッド I Cとは、お客様の要求に応じて最適な回路構成・外形構造を実現したカスタム仕様の I Cです。

弊社のハイブリッド I Cは、厚膜印刷やベアチップ搭載など幅広い実装技術で、お客様の製品の小型化に貢献いたします。また、超小型基板から高密度実装基板の組み立てまで、長年培った製造品質で生産対応いたします。

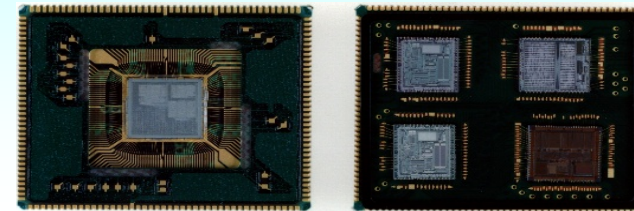
セラミック基板

アナログ・デジタル混在、機能トリミングも可能。
ほとんどの回路がハイブリッド I C化できます。



ガラスエポキシ基板

ベアチップ搭載による高密度実装ができます。
外形の自由度が高く、大型基板も可能です。

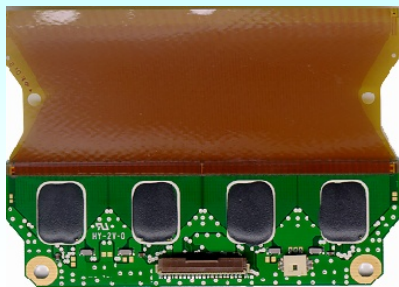


ハイブリッド I C 実装技術

フレキシブル基板

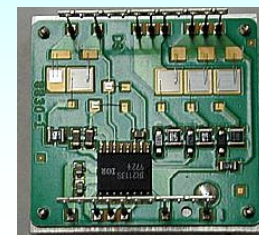
ベアチップ搭載による
高密度実装ができます。

折り曲げ可能な基板で
外形の自由度が高く
大型基板も可能です。




アルミ基板

放熱性、シールド性に優れています。
電装用の高信頼性ハイブリッド I Cも対応できます。



<http://www.kohzan.co.jp/akita/>

 光山電気工業株式会社